

硅片芯片划片晶圆激光切割划线开孔加工支持个性来图定制

产品名称	硅片芯片划片晶圆激光切割划线开孔加工支持个性来图定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

硅片芯片划片晶圆激光切割划线开孔加工支持个性来图定制，承接0.1mm-1.0mm各种激光切割、开孔钻孔、划线、开槽、刻图形字体，各种规格尺寸都可做，价格优惠，华诺激光切割打孔刘经理期待您的垂询。

硅片规格有多种分类方法，可以按照硅片直径：4寸、6寸、12寸、3英寸、2英寸；单晶生长方法：单晶硅片、多晶硅片；掺杂类型：N型、P型等参量和用途来划分种类。